

TIF®100C 10075-11系列是一种硅胶导热材料，专为填充发热器件与液冷板或金属底座之间的间隙设计。它的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。凭借卓越的热传导性能，其能够将热量快速从发热元件或PCB传递到液冷板或金属散热结构，从而提升高功率电子组件的散热效率，延长设备的使用寿命。

特性

- 》良好的热传导率
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性,柔软兼有弹性
- 》可提供多种厚度选择
- 》良好的化学稳定性

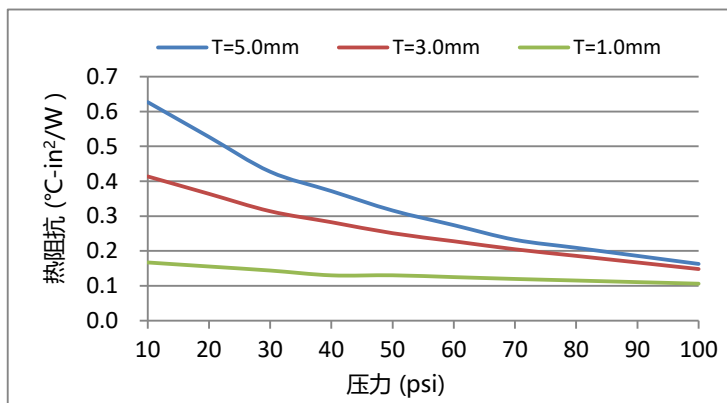
应用

- 》CPU、GPU处理器等芯片组
- 》高性能计算 (HPC)
- 》工业设备
- 》网络通讯设备
- 》新能源汽车

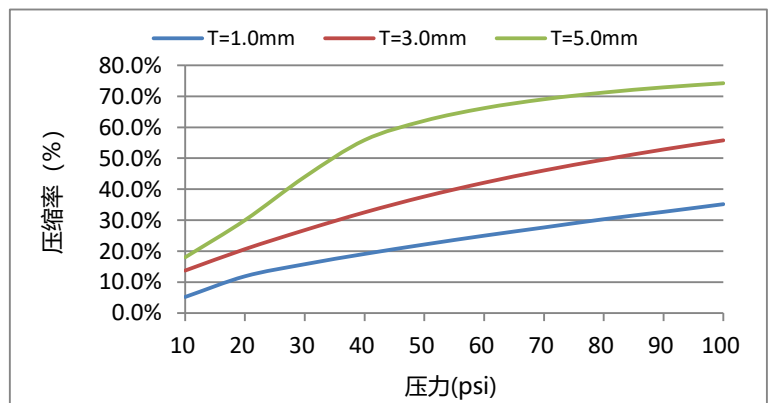
TIF®100C 10075-11 系列特性表

| 产品特性 | 典型值 | 测试方法 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 颜色 | 灰色 | Visual |
| 结构&成份 | 陶瓷填充硅橡胶 | - |
| 厚度范围 | 0.020"(0.50mm)~0.200" (5.0mm) | ASTM D374 |
| 硬度 (Shore OO) | 75 | ASTM D2240 |
| 密度 (g/cm ³) | 3.3 | ASTM D792 |
| 建议使用温度范围 (°C) | -40~200 | 内部测试 |
| 击穿电压 (T=1.0mm, Vac) | ≥5500 | ASTM D149 |
| 介电常数 @1MHz | 5.5 | ASTM D150 |
| 体积电阻率 (Ohm-cm) | ≥1.0X10 ¹² | ASTM D257 |
| 导热系数 (W/mK) | 10.0 | ASTM D5470 |
| | 10.0 | ISO22007-2.2 |
| 防火等级 | V-0 | UL 94 |

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度:0.020"(0.5mm)~0.200" (5.0mm) 标准尺寸:8"×16" (203mm×406mm)

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

安全处置方法无需特别防护，存储方法低温干燥，远离明火，避免阳光直射即可，详细方法可参考产品物质安全资料表。



导热材料

导热工程塑料

发热材料

屏蔽材料

发泡硅胶

模切制品

加拿大 Canada

TEL: +001-604-2998559
E-mail: frances@ziitek.com.tw
[Http://www.thermazig.com](http://www.thermazig.com)

台湾 Taiwan

TEL: +886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw
[Http://www.ziitek.com.tw](http://www.ziitek.com.tw)

东莞 Dongguan

TEL: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)

昆山 Kunshan

TEL: +86-512-57816297
E-mail: kelvin@ziitek.com
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)

长沙 Changsha

TEL: +86-731-86949836
E-mail: jor@ziitek.com
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)